## THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION

Patent number:

JP5320497

Publication date:

1993-12-03

Inventor:

FUKUMOTO TADAO; CHIBA KAZUMASA

Applicant:

TORAY INDUSTRIES

Classification:
- international:

C08K3/24; C08L25/04; C08L71/12; C08L77/00;

C08L101/02; C08K3/00; C08L25/00; C08L71/00; C08L77/00; C08L101/00; (IPC1-7): C08L71/12; C08K3/24; C08L25/04; C08L71/12; C08L77/00;

C08L101/02

- european:

Application number: JP19920134906 19920527 Priority number(s): JP19920134906 19920527

Report a data error here

#### Abstract of JP5320497

PURPOSE:To obtain a thermoplastic resin composition which can give a molding excellent in permanent antistatic properties, mechanical properties and heat resistance with an excellent balance among them and improved in delamination resistance. CONSTITUTION:This composition comprises 1-40 pts.wt. polyamide elastomer containing a soft component comprising a polyalkylene glycol based on polyethylene glycol, 95-1 pt.wt. polyphenylene ether, 1-60 pts.wt. polyamide resin, 0.1-50 pts.wt. modified vinyl polymer containing at least one kind of functional groups selected from among carboxyl, epoxy, amino, hydroxyl, polyalkylene oxide and oxazoline groups and 0-95 pts.wt. styrenic resin (the total of the amounts of the above components being 100 pts.wt.).

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-320497

(43)公開日 平成5年(1993)12月3日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C08L 71/12	LQP	9167-4 J		•
	LQN	9167-4 J		
C08K 3/24	KKR	7242-4 J	•	
C08L 25/04	LED	9166-4 J		•
	LEE	9166—4 J		
		•	審査請求 未請求	さ 請求項の数1(全 12 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平4-134906		(71)出願人	000003159
				東レ株式会社
(22)出願日	平成 4年(1992) 5	月27日		東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
			(72)発明者	福本 忠男
				愛知県名古屋市港区大江町 9番地の 1 東
	•			レ株式会社名古屋事業場内
			(72)発明者	千葉 一正
•				愛知県名古屋市港区大江町 9番地の1 東
				レ株式会社名古屋事業場内
•				
			ŀ	

## (54) 【発明の名称 】 熱可塑性樹脂組成物

#### (57)【要約】

【構成】(A)ソフト成分がポリエチレングリコールを 主成分とするポリアルキレングリコールであるポリアミ ドエラストマー1~40重量部、(B) ポリフェニレン エーテル95~1重量部、(C)ポリアミド樹脂1~6 0重量部、(D)カルボキシル基、エポキシ基、アミノ 基、ヒドロキシル基、ポリアルキレンオキシド基、オキ サゾリン基から選ばれた少なくとも1種の官能基を含有 する変性ビニル系重合体0.1~50重量部および (E)スチレン系樹脂0~95重量部((A)+(B) + (C) + (D) + (E) の合計を100重量部とす る)を配合してなる熱可塑性樹脂組成物。 【効果】本発明の熱可塑性樹脂組成物は永久帯電防止 性、機械的性質、耐熱性が均衡してすぐれ、かつ成形品 の層状剥離防止性がすぐれ、〇A機器、家電機器、自動 車内装部品などのハウジングおよびそれらの耐熱性を要 する部品類に有用である。

10

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)ソフト成分がポリエチレングリコールを主成分とするポリアルキレングリコールであるポリアミドエラストマー1~40重量部、(B)ポリフェニレンエーテル95~1重量部、(C)ポリアミド樹脂1~60重量部、(D)カルボキシル基、エポキシ基、アミノ基、ヒドロキシル基、ポリアルキレンオキシド基、オキサゾリン基から選ばれた少なくとも1種の官能基を含有する変性ビニル系重合体0.1~50重量部、および(E)スチレン系樹脂0~95重量部の合計量((A)+(B)+(C)+(D)+(E)=100重量部)に対し、(F)アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、アルミニウム金属から選ばれた無機金属塩0~10重量部を配合してなる熱可塑性樹脂組成物。【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は永久帯電防止性を有すると共に、耐衝撃性に代表される機械的性質、耐熱性、剛性、耐薬品性、加工性にすぐれ、かつ層状剥離(千枚めくれ)のない熱可塑性樹脂組成物に関する。

## [0002]

【従来の技術】合成高分子材料は、そのすぐれた機械的 性質、加工性によって広範な分野で使用されているが電 気絶縁体である。これらの材料の持つ機械的強度に加 え、帯電防止性を付与されれば、さらにその用途を拡大 することができる。すなわち、静電気による障害を防止 したい複写機、ファクシミリー、ワードプロセッサー、 パーソナルコンピューター、テレビなどの電子、電気機 械部品、各種防塵用部品などの用途展開が可能になる。 【0003】合成高分子材料の静電性を向上させる方法 30 としては、共役ジェンおよび/またはアクリル酸エステ ルとアルキレンオキシド基を有するビニル系単量体を共 重合して得られる親水性ゴム状重合体にビニル系単量体 またはピニリデン単量体をグラフト重合して得る方法 (特開昭55-36237号公報)、ポリフェニレンエ ーテル系樹脂にポリアミドエラストマーを配合してなる 組成物(特開昭60-186560号公報)、ポリエー テルエステルアミドとポリフェニレンエーテル樹脂およ びポリアミド樹脂を配合してなる組成物(特開平2-1 67363号公報)が開示されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の特開昭55-36237号公報記載の親水性ゴム状重合体を使用しているため、その製造方法が煩雑なこと、および得られる樹脂の機械的性質が劣る欠点がある。また、特開昭60-186560号公報記載の組成物は耐摩耗性を改良しているが帯電防止性、層状剥離防止性に劣る。更に、特開平2-167363号公報記載の組成物は耐衝撃性、帯電防止性にすぐれるものの、柔軟で、かつ高価なポリエーテルエステルアミドを多量に使用す 50

るため、剛性および層状剥離防止性が劣るうえに、コスト高となり経済的に不利である。

【0005】本発明は永久帯電防止性を有し、かつ耐衝撃性に代表される機械的性質、耐熱性、耐薬品性、成形加工性、層状剥離防止性にすぐれ、かつ経済的に有利な制電性樹脂を提供することを課題とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決すべく鋭意検討した結果、特定のポリアミドエラスト マーと特定のポリフェニレンエーテル系樹脂およびポリ アミド樹脂を配合することにより、上記目的が効率的に 達成されることを見出し本発明に到達した。

【0007】すなわち、本発明は(A)ソフト成分がポリエチレングリコールを主成分とするポリアルキレングリコールであるポリアミドエラストマー1~40重量部、(B)ポリフェニレンエーテル95~1重量部、(C)ポリアミド樹脂1~60重量部、(D)カルボキシル基、エポキシ基、アミノ基、ヒドロキシル基、ポリアルキレンオキシド基、オキサゾリン基から選ばれた少なくとも1種の官能基を含有する変性ビニル系重合体の、1~50重量部、(E)スチレン系樹脂0~95重量部の合計量((A)+(B)+(C)+(D)+(E)=100重量部)に対し、(F)アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、アルミニウム金属から選ばれた無機金属塩0~10重量部を配合してなる熱可塑性樹脂組成物である。

【0008】以下、本発明を具体的に説明する。

【0009】本発明における(A)ポリアミドエラスト マーとは(a)ポリアミド形成性成分とソフト成分の (b) ポリエチレングリコールとジカルボン酸からなる ポリエーテルエステル形成性成分との反応によって得ら れるポリエーテルエステルアミド、および(a)ポリア ミド形成性成分と(b)ポリエチレングリコールの両末 端をアミノ化またはカルボキシル化したものとジカルボ ン酸またはジアミンからなるポリエーテル形成性成分と の反応によって得られるポリエーテルアミドである。 【0010】(a)ポリアミド形成性成分としては具体 的には、ωーアミノカブロン酸、ωーアミノエナント 酸、ωーアミノカブリル酸、ωーアミノベルゴン酸、ω -アミノカプリン酸、および11-アミノウンデカン 酸、12-アミノドデカン酸などのアミノカルボン酸あ るいはカプロラクタム、エナントラクタム、カプリルラ クタムおよびラウロラクタムなどのラクタムおよびヘキ サメチレンジアミンーアジピン酸塩、ヘキサメチレンジ アミンーセパシン酸塩およびヘキサメチレンジアミンー イソフタル酸塩などのジアミン-ジカルボン酸の塩が挙 げられ、特にカブロラクタム、12-アミノドデカン 酸、ヘキサメチレンジアミン-アジピン酸塩が好ましく 用いられる。

o 【0011】本発明で用いられる(b)ポリエチレング

リコールは数平均分子量が200~10、000、特に 400~6,000の範囲が重合性にすぐれる点で好ま しい。

【0012】本発明においては、(A)ポリアミドエラ ストマーのソフト成分としてポリエチレングリコールを 選択したことが重要である。

【0013】ソフト成分として、ポリテトラメチレング リコールなどの他の成分を用いた場合は本発明の課題で ある帯電防止性や機械的性質が均衡して改良されず、本 発明の課題を達成することができない。

【0014】本発明で用いられる(b)ポリエチレング リコールは両末端をアミノ化またはカルボキシル化した ものを用いることができる。

【0015】本発明で用いられるジカルボン酸成分とし ては、炭素原子数4~20のものが好ましい。具体的に はテレフタル酸、イソフタル酸、フタル酸、ナフタレン -2,6-ジカルボン酸、ナフタレン-2,7-ジカル ボン酸、ジフェニルー4、4'ージカルボン酸、ジフェ ノキシエタンジカルボン酸および3-スルホイソフタル 酸ナトリウムのごとき芳香族ジカルボン酸、1,4-シ 20 クロヘキサンジカルボン酸、1,2-シクロヘキサンジ カルボン酸およびジシクロヘキシル-4、4'-ジカル ボン酸のどとき脂環族ジカルボン酸およびコハク酸、シ ュウ酸、アジピン酸、セバシン酸およびドデカンジ酸 \*

$$\frac{\mathbb{R}^4}{\mathbb{R}^3} \underbrace{\mathbb{R}^2}_{\mathbb{R}^1} \xrightarrow{\mathbb{R}}$$

( $CCC^*$ 、 $R^*$ 、 $R^*$  は  $R^*$  は  $CCC^*$  は  $CCC^*$  は  $CCC^*$  ない  $R^*$  、 $R^*$  、 $R^*$  は  $R^*$  は  $CCC^*$  は  $CCC^*$  ない  $R^*$  、 $R^*$  、 $R^*$  ない  $R^*$  は  $R^*$  ない  $R^*$  ない に水素、ハロゲン、炭化水素、ハロ炭化水素、炭化水素 オキシおよびハロ炭化水素オキシで構成される群から選 択され、nはモノマー単位の整数を表わし20以上の整 数である。)

【0021】また、(B) ポリフェニレンエーテルはポ リフェニレンエーテルに芳香族ピニル系単量体をグラフ ト重合して得られるグラフト重合体も包含する。

【0022】ポリフェニレンエーテルの製造方法は特に 制限されないが、例えば米国特許第3,306,874 号明細書および第3.306.875号明細書ならびに 40 米国特許第3,257,357号明細書および第3,2 57,358号明細書に記載のごとき手順に従ってフェ ノール類の反応によって製造することができる。これら のフェノール類には、2,6-ジメチルフェノール。 2, 6-ジエチルフェノール、2, 6-ジプチルフェノ ール、2、6-ジラウリルフェノール、2、6-ジプロ ピルフェノール、2、6-ジフェニルフェノール、2-メチルー6ーエチルフェノール、2ーメチルー6ーシク ロヘキシルフェノール、2-メチル-6-トリルフェノ ール、2-メチルー6-ブチルフェノール、2,6-ジ 50

\* (デカンジカルボン酸)のごとき脂肪族ジカルボン酸な どが挙げられ、特にテレフタル酸、イソフタル酸、1, 4-シクロヘキサンジカルボン酸、セバシン酸、アジビ ン酸およびドデカンジ酸が重合性、色調および物性の点 から好ましく用いられる。

【0016】ジアミン成分としては例えば芳香族、脂環 族、脂肪族ジアミンが挙げられる。その中で脂肪族ジア ミンのヘキサメチレンジアミンが経済的な理由から好ま しく用いられる。

10 【0017】本発明で用いる(A)ポリアミドエラスト マーの(a)ポリアミド形成性成分/(b)ポリエーテ ルエステル形成性成分またはポリエーテル形成性成分の 割合は10/90~90/10重量%、特に20/80 ~70/30重量%の範囲が樹脂組成物の耐衝撃性、帯 電防止性にすぐれ好ましい。

【0018】(A)ポリアミドエラストマーの製法に関 しては特に制限されず、例えば特開昭56-65026 号公報、特開昭55-133424号公報などに開示さ れている方法を利用することができる。

【0019】本発明で用いる(B)ポリフェニレンエー テルとしては次式(1)の単位を有するホモポリマーま たはコポリマーが望ましい。

[0020]

[{t] ]

(I)

ル、2,3,5,6-テトラメチルフェノール、および 2. 6-ジエトキシフェノールが包含されるがこれらに 限定されるものではない。

【0023】とれらの各々は単独に反応させて対応する ホモポリマーとしてもよいし、別のフェノールと反応さ せて上記式に包含される異なる単位を有する対応のコポ リマーとしてもよい。特配すると、2、6-ジメチルフ ェノールとこれに対応するポリマー、すなわちポリ

(2,6-ジメチル-1,4-フェノール)エーテル、 ならびに2,6-ジメチルフェノールと他のフェノール 類、例えば2, 3, 6-トリメチルフェノール、2-メ チルー6ープチルフェノールなどとの併用およびこれら に対応するコポリマー、例えばポリ(2,6-ジメチル エーテルなどが挙げられる。

【0024】本発明で用いる(B)ポリフェニレンエー テルはポリフェニレンエーテルと不飽和ジカルボン酸ま たは不飽和カルボン酸とを反応して得られる変性ポリフ ェニレンエーテル樹脂を全ポリフェニレンエーテルに対 し、50重量%以下含有することによって、ポリアミド エラストマー (A)、ポリフェニレンエーテル (B) お よびポリアミド樹脂(C)の相溶性を一層向上させると

【0025】本発明で用いる(B)変性ポリフェニレン エーテル樹脂における不飽和ジカルボン酸または不飽和 カルボン酸としては、具体的には、マレイン酸、クロロ マレイン酸、シトラコン酸、フタル酸、イタコン酸など の不飽和ジカルボン酸、アクリル酸、ブラン酸、クロト ン酸、ビニル酢酸、メタクリル酸、ペンテン酸、アンゲ リカ酸などの不飽和カルボン酸が挙げられ、特にマレイ 10 ン酸、無水マレイン酸、アクリル酸、メタクリル酸がポ リアミドエラストマー、ポリアミド樹脂との相溶性にす ぐれる点で好ましい。

【0026】本発明で用いる(B)変性ポリフェニレン エーテル樹脂はラジカル開始剤の存在下にポリフェニレ ンエーテルと不飽和ジカルボン酸または不飽和カルボン 酸とを反応させて調製することもできる。

【0027】ラジカル開始剤としては特に制限されない が、例えばベンゼン溶媒中で、10時間の半減期温度6 O°C以上の有機過酸化物またはアゾ化合物が挙げられ る。具体的には、ベンゾイルパーオキサイド、1,1-ピス(t-ブチルパーオキシ)3,3,5-トリメチル シクロヘキサン、2,5-ジメチル-2,5-ジ(ベン ゾイルバーオキシ) ヘキサン、t - ブチルパーオキシア セテート、t-ブチルパーオキシベンゾエート、メチル エチルケトンパーオキサイド、ジクミルパーオキサイ ド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオ キシ) ヘキサン、ジーtーブチルパーオキサイド、2. 5-ジメチル-2, 5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へ キシン-3、クメンハイドロパーオキサイド、t - ブチ ルハイドロバーオキサイドなどの有機過酸化物、アゾビ スイソブチロニトリル、アゾビスシクロヘキシルニトリ ルなどのアゾ化合物が挙げられる。

【0028】本発明で用いる(B)変性ポリフェニレン エーテルの調製は特に制限がないが、例えば、(1)ポ リフェニレンエーテルと不飽和ジカルボン酸または不飽 和カルボン酸、更に必要に応じてラジカル開始剤とをロ ール、バンバリーミキサー、押出機を用いて200~3 50°Cの温度範囲で溶融混練して反応させる方法、

(2) ベンゼン、トルエン、キシレン、デカリン、テト ラリンなどの溶媒中でポリフェニレンエーテルと不飽和 ジカルボン酸または不飽和カルボン酸、更に必要に応じ てラジカル開始剤とを加熱下で反応させる方法などを用 いるととができる。

【0029】本発明における(C)ポリアミド樹脂とし てはカプロラクタム、エナントラクタム、ドデカノラク タム、ウンデカノラクタムなどのラクタム類、ローアミ ノカプロン酸、ωーアミノエナント酸、ωーアミノカブ リル酸、ω-アミノベルゴン酸、ω-アミノカブリン酸 および11-アミノウンデカン酸、12-アミノドデカ SO グリシジル、アリルグリシジルエーテル、スチレン-p

ン酸などのアミノカルボン酸類、ナイロン-6・6、- $6 \cdot 9$ ,  $-6 \cdot 10$ ,  $-6 \cdot 12$ ,  $-11 \cdot 6$ , -12・6 などの前駆体であるジアミンージカルボン酸の塩類 の重合体があり、特にカプロラクタム、11-アミノウ ンデカン酸、12-アミノドデカン酸、ナイロン-6・ 6塩、-6・10塩、-6・12塩、-11・6塩の重 合体が好ましい。

【0030】(C)ポリアミド樹脂の重合度は特に制限 されないが、硫酸中、25℃、1.0%濃度で測定した 相対粘度が1.1~5.0、特に1.5~4.0の範囲 が好ましい。(C)ポリアミド樹脂の製造法にも特に制 限はなく、通常の重合法を用いることができる。

【0031】本発明における(D)カルボキシル基、エ ポキシ基、アミノ基、ヒドロキシル基、ポリアルキレン オキシド基、オキサゾリン基から選ばれた少なくとも一 種の官能基を含有する変性ビニル系重合体(以下、変性 ビニル系重合体と略称する)としては、一種または二種 以上のビニル系単量体を重合または共重合して得られる 構造を有し、かつ分子中にカルボキシル基、エポキシ 基、アミノ基、ヒドロキシル基、ポリアルキレンオキシ ド基、オキサゾリン基から選ばれた少なくとも一種の官 能基を含有する重合体である。これらの官能基を有する 化合物の含有量に関しては、制限されないが、特に変性 ビニル系重合体100重量部当り0.1~20重量%の 節囲が好ましい。

【0032】通常は、変性ビニル系重合体の1分子中に 実質的に平均一種以上の上記官能基を含有すれば本発明 の効果が効果的に発揮される。

【0033】(D)変性ビニル系重合体中にカルボキシ ル基を導入する方法は特に制限はないが、Oアクリル 酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フタ ル酸およびイタコン酸などのカルボキシル基または無水 カルボキシル基を有するビニル系単量体を所定のビニル 系単量体と共重合する方法、②γ, γ' - アゾビス(γ -シアノバレイン酸)、 $\alpha$ ,  $\alpha'$  -アゾビス( $\alpha$ -シア ノエチル)-p-安息香酸および過酸化サクシン酸など のカルボキシル基を有する重合開始剤および/またはチ オグリコール酸、αーメルカプトプロピオン酸、βーメ ルカプトプロピオン酸、α-メルカプト-イソ酪酸およ び2、3または4-メルカプト安息香酸などのカルボキ シル基を有する重合度調節剤を用いて、所定のビニル系 重合体を(共)重合する方法および◎メタクリル酸メチ ルやアクリル酸メチルなどの(メタ)アクリル酸エステ ル系単量体と芳香族ビニル系単量体、必要に応じてシア ン化ビニル系単量体との共重合体をアルカリによってケ ン化する方法などを用いることができる。

【0034】エポキシ基を導入する方法についても特に 制限はないが、例えばアクリル酸グリシジル、メタクリ ル酸グリシジル、エタクリル酸グリシジル、イタコン酸

グリシジルエーテル、p - グリシジルスチレンなどを 所定のビニル系単量体と共重合する方法などを用いると とができる。

【0035】アミノ基を導入する方法においても特に制 限はないが、例えば次式(II)

[化2]

$$--N$$
 $\stackrel{R^5}{\sim}$ 
(11)

(ただし、式中R'は水素、メチル基、エチル基を表わ し、R<sup>6</sup> は水素、炭素原子数1~12のアルキル基、炭 素原子数2~12のアルカノイル基、炭素原子数6~1 2のフェニル基またはシクロアルキル基あるいはそれら の誘導体類を示す。)で表わされるアミノ基または置換 アミノ基の少なくとも一種の官能基を有するビニル系単 量体を所定のビニル系単量体と共重合する方法などを用 いることができる。

くとも一種の官能基を有するビニル系単量体の具体例と してはアクリル酸アミノエチル、アクリル酸プロビルア ミノエチル、メタクリル酸ジメチルアミノエチル、メタ クリル酸エチルアミノプロピル、メタクリル酸フェニル アミノエチルおよびメタクリル酸シクロヘキシルアミノ エチルなどのアクリル酸またはメタクリル酸のアルキル エステル系誘導体類、N-ビニルジエチルアミンおよび N-アセチルビニルアミンなどのビニルアミン系誘導体\* \*類、アリルアミン、メタアリルアミンおよびN-メチル アリルアミンなどのアリルアミン系誘導体類、アクリル アミド、メタクリルアミドおよびN-メチルアクリルア ミド、ブトキシメチルアクリルアミド、N-プロピルメ タクリルアミドなどの (メタ) アクリルアミド系誘導体 およびp-アミノスチレンなどのアミノスチレン類など が挙げられる。

【0037】ヒドロキシル基を導入する方法についても 特に制限はないが、例えばアクリル酸2-ヒドロキシエ 10 チル、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル、アクリル酸 3-ヒドロキシプロビル、メタクリル酸3-ヒドロキシ プロピル、アクリル酸2、3、4、5、6-ペンタヒド ロキシヘキシル、メタクリル酸2,3,4,5,6-ペ ンタヒドロキシヘキシル、アクリル酸2,3,4,5-テトラヒドロキシベンチル、メタクリル酸2、3、4、 5-テトラヒドロキシペンチル、3-ヒドロキシ-1-プロペン、4-ヒドロキシ-1-ブテン、シス-4-ヒ ドロキシー2ープテン、トランスー4ーヒドロキシー2 ープテン、3ーヒドロキシー2ーメチルー1ープロペ 【0036】 CCでアミノ基または置換アミノ基の少な 20 ン、シス-5-ヒドロキシ-2-ベンテン、トランス-5-ヒドロキシ-2-ペンテン、4-ジヒドロキシ-2 -ブテンなどを所定のビニル系単量体と共重合する方法 などを用いることができる。

> 【0038】またポリアルキレンオキシド基を導入する 方法についても特に制限はないが、例えば、(1)次式 (III), (IV) (1k3)

$$R^{7} O$$
 $CH_{2} = C - C - O(R^{8} O)_{n} R^{9}$ 
 $R^{7} O$ 
 $III$ 
 $CH_{2} = C - C - NH(R^{8} O)_{n} R^{9}$ 
 $CH_{2} = C - C - NH(R^{8} O)_{n} R^{9}$ 
 $(IV)$ 

(5)

(ただし、式中、R'は水素または炭素原子数1~4の アルキル基、R®は炭素原子数2~6のアルキル基、R 40 \* は水素または炭素原子数1~6のアルキル基を示し、 nは2~500を示す。) で表わされるポリアルキレン オキシド基を含有するビニル系単量体を所定のビニル系 単量体と共重合する方法を用いることができる。

【0039】具体的な例としては、ポリエチレングリコ ールアクリレート、ポリエチレングリコールメタクリレ ート、ポリ(プロピレンオキシド)グリコールアクリレ ート、ポリ (プロピレンオキシド) メタクリレート、ポ リ (テトラメチレンオキシド) グリコールアクリレー

リレート、ポリ (ヘキサメチレンオキシド) グリコール メタクリレート、メトキシポリエチレングリコールアク リレート、メトキシポリエチレングリコールメタクリレ ート、メトキシボリ (プロピレンオキシド) グリコール アクリレート、メトキシポリ(プロビレンオキシド)グ リコールメタクリレート、メトキシポリ(テトラメチレ ンオキシド) グリコールメタクリレート、エトキシポリ エチレングリコールアクリレート、エトキシポリエチレ ングリコールメタクリレート、エトキシポリ (プロピレ ンオキシド) グリコールアクリレート、ポリエチレング リコールアクリルアミド、ポリエチレングリコールメタ ト、ポリ(テトラメチレンオキシド)グリコールメタク 50 クリルアミド、ポリ (プロピレンオキシド) グリコール

10

アクリルアミド、ポリ (プロピレンオキシド) グリコー ルメタクリルアミド、ポリ(テトラメチレンオキシド) グリコールアクリルアミド、ポリ (テトラメチレンオキ シド) グリコールメタクリルアミド、メトキシポリエチ レングリコールアクリルアミド、メトキシポリエチレン グリコールメタクリルアミド、メトキシポリ(プロピレ ンオキシド) グリコールアクリルアミド、メトキシポリ (プロピレンオキシド) グリコールメタクリルアミド、 メトキシ (テトラメチレンオキシド) グリコールメタク リルアミドなどが挙げられる。

【0040】また、(2)アクリル酸、メタクリル酸、 マレイン酸、無水マレイン酸、フタル酸などを所望のビ ニル系単量体と共重合する方法などによって得られるカ ルボキシル基を含有するビニル系単量体と片末端がアル キルエーテルのポリアルキレンオキシドグリコールとの エステル反応を高温で常圧または減圧下で行なう方法も 用いることができる。

【0041】ここで用いる片末端がアルキルエーテルの ポリ (アルキレンオキシド) グリコールとは、例えばメ - プロピレンオキシド) グリコール、メトキシボリ

(1, 3-プロビレンオキシド) グリコール、メトキシ ポリ (テトラメチレンオキシド) グリコール、メトキシ ポリ (ヘキサメチレンオキシド) グリコール、メトキシ (エチレンオキシドとプロピレンオキシドのプロックま たはランダム共重合体) およびメトキシ (エチレンオキ シドとプロピレンオキシドのブロックまたはランダム共 重合体)などが挙げられる。片末端がアルキレンエーテ ルのポリ(アルキレンオキシド)グリコールの数平均分 子量は75~20,000の範囲で用いられる。

【0042】オキサゾリン基を導入する方法においても 特に制限はないが、例えば2-ビニル-2-オキサゾリ ン、5-メチル-2-ビニル-2-オキサゾリン、2-イソプロペニルー2ーオキサゾリン、2ーアクロイルー 2-オキサゾリン、2-スチリル-2-オキサゾリン、 4. 4-ジメチル-2-ビニル-2-オキサゾリン、

4. 4-ジメチル-2-イソプロペニル-2-オキサゾ リンなどを所定のビニル系単量体と共重合する方法など を用いることができる。

【0043】(D)変性ビニル系重合体の重合に用いら れるビニル系重合体については特に制限はなく、例え ぱ、スチレン、αーメチルスチレン、ビニルトルエンな どの芳香族ビニル系単量体、アクリロニトリル、メタク リロニトリルなどのシアン化ビニル系単量体、メタクリ ル酸メチル、メタクリル酸エチル、アクリル酸メチル、 アクリル酸ブチルなどの (メタ) アクリル酸エステル系 単量体、マレイミド、N-メチルマレイミド、N-シク ロヘキシルマレイミド、N-フェニルマレイミドなどの マレイミド系単量体、エチレン、プロピレンなどのオレ イン系単量体および塩化ビニル、酢酸ビニル、ブタジエ 50 【0050】とこで、スチレン系樹脂としては、特にH

ンなどのビニル系単量体から一種または二種以上を目的 に合わせて選んで用いることができる。特に、スチレン 等の芳香族ビニル系単量体、メタクリル酸メチルなどの (メタ) アクリル酸エステル系単量体、アクリロニトリ ルなどのシアン化ビニル系単量体、N-フェニルマレイ

10

【0044】なお、必要によってはポリブタジエン、ア クリロニトリル/ブタジエン共重合体(NBR)、スチ レンノブタジェン共重合体(SBR)、ポリアクリル酸 ブチルおよびエチレン/ブロピレン/ジエン系ゴム(E PDM) などのゴム状重合体を上記のビニル系単量体と 併せて用いることもできる。

ミドなどのマレイミド系単量体が好ましい。

【0045】また、官能基の導入方法は上記の種々の方 法を任意に組合せて用いることもできる。

【0046】(D)変性ビニル系重合体の製造法にも特 に制限はなく、塊状重合法、溶液重合法、懸濁重合法、 乳化重合法、塊状-懸濁重合法などの通常の方法を用い ることができる。

【0047】本発明における(E)スチレン系樹脂とは トキシポリエチレングリコール、メトキシポリ(1,2 20 スチレン単位を10重量%以上含む(共)重合体、ゴム 質重合体1~80重量部にスチレン10重量%以上含む 単量体または単量体混合物99~20重量部をグラフト 重合してなるグラフト (共) 重合体およびそれらの混合 物である。

> 【0048】上記ゴム質重合体としては、ガラス転移温 度が0°C以下のものが好適であり、具体的にはポリブタ ジエン、スチレンーブタジエン共重合体、アクリロニト リループタジエン共重合体、スチレンープタジエンのブ ロック共重合体、アクリル酸プチループタジエン共重合 30 体およびそれらの水素添加物等のジェン系ゴム、ポリア クリル酸ブチル等のアクリル系ゴム、ポリイソプレン、 ポリクロロプレン、エチレン-プロピレン-ジエン系モ ノマ三元共重合体、塩素化ポリエチレンなどが挙げられ

【0049】本発明における(E)スチレン系樹脂とし ては、具体的にはポリスチレン、ゴム変性ポリスチレン (HI-PS樹脂)、スチレン-アクリロニトリル共重 合体、スチレンーゴム質重合体-アクリロニトリル共重 合体 (ABS樹脂、AES樹脂、AAS樹脂、ACS樹 脂)などが挙げられる。これらは2種以上用いることも できる。さらにこれらのスチレンの一部、および/また はアクリロニトリルの一部または全部をα-メチルスチ レン、p-メチルスチレン、p-t-ブチルスチレン、 (メタ) アクリル酸のメチル、エチル、プロピル、n-ブチルなどのエステル化合物、マレイミド、Nーメチル マレイミド、N-シクロヘキシルマレイミド、N-フェ ニルマレイミドなどのマレイミド系単量体等のスチレン と共重合可能なビニル系単量体に置換されているものも 含まれる。

I-PS樹脂、ABS樹脂、AES樹脂、AAS樹脂、ACS樹脂、MBS樹脂などが好ましく用いられる。その場合、ゴム質重合体は樹脂組成物中に40重量%以下、好ましくは30重量%以下である。40重量%を越える場合は樹脂組成物が柔軟になり好ましくない。

【0051】(E) スチレン系樹脂の製造法にも制限はなく、塊状重合法、懸濁重合法、乳化重合法、塊状-懸濁重合法などの通常の方法を用いることができる。

【0052】本発明における(A)ポリアミドエラストマー、(B)ポリフェニレンエーテル、(C)ポリアミド樹脂、(D)変性ビニル系重合体および(E)スチレン系樹脂の割合は、(A)成分、(B)成分、(C)成分、(D)成分および(E)成分の合計量100重量部に対し、(A)成分が1~40重量部、好ましくは5~30重量部、(B)成分が95~1重量部、好ましくは90~5重量部、(C)成分が1~60重量部、好ましくは5~40重量部、(D)成分が0.1~50重量部、好ましくは1~30重量部、(E)成分が0~95重量部、好ましくは1~80重量部である。ただし、(A)+(B)+(C)+(D)+(E)の合計は10

【0053】(A)ポリアミドエラストマーが1重量部未満では樹脂組成物の帯電防止性が不足し、40重量部を越える場合は樹脂組成物が柔軟になり、機械的性質が劣るため好ましくない。(B)ポリフェニレンエーテルが95重量部を越える場合は帯電防止性が不足し、5重量部未満では耐熱性が劣り好ましくない。(C)ポリアミド樹脂が1重量部未満では帯電防止性が改善されず、60重量部を越える場合は耐衝撃性が悪く好ましくない。(D)変性ビニル系重合体が0.1重量部では耐衝 30撃性、層状剥離防止性が悪く、50重量部を越える場合は耐衝撃性、成形品の外観が悪くなり使用できない。

0重量部とする。

(E)スチレン系樹脂が95重量部を越える場合帯電防 止性が悪くなり好ましくない。

【0054】本発明は上記樹脂組成物にアルカリ金属、\*

\*アルカリ土類金属、遷移金属、アルミニウム金属から選ばれた無機金属塩(F)(以降、無機金属塩と略称する)を配合すると、剛性、帯電防止性、金属の耐蝕性が改善される。

【0055】本発明における(F)無機金属塩の金属としては、Li、Na、K、Rb、Cs、Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Ti、Zr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Alなどが挙げられる。特にLi、Na、K、Ca、Mg、Zn、Alが好ましい。

10 【0056】一方、上記の金属と塩を形成する基としては、硝酸、硫酸、塩素塩、過塩素酸、チオシアン酸、炭酸、シュウ酸、ケイ酸、リン酸、ホウ酸、シアン酸、ハロゲン、水酸、酸素などが挙げられ、これらのうちで、過塩素酸、チオシアン酸、水酸、酸素、炭酸、ケイ酸、ハロゲンが好ましい。具体的には、チオシアン酸ナトリウム、チオシアン酸カリウム、チオシアン酸リチウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化カリウム、ヨウ化リチウムが20 帯電防止性の改善にすぐれる点で好ましい。

【0057】また、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化亜鉛、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、炭酸カルシウム、塩基性炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、塩基性炭酸マグネシウム、炭酸アルミニウム、炭酸亜鉛、ケイ酸カリウム、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウムおよびハイドロタルサイトが挙げられ、なかでも水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ハイドロタルサイトが特に金属の耐蝕性にすぐれる点で特に好ましい。

【0058】 ここで、ハイドロタルサイトとは一般式 【化4】

 $[M_{1-X}^{2+} M_{X}^{3+} (OH)_{2}]^{X+} [A_{X/n}^{n-} - mH_{2} O]^{X-}$ 

(式中、 $M^{2+}: Mg^{2+}, Mn^{2+}, Fe^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}$ 

(7)

などの2価金属。

 $M^{3+}: A 1^{3+}, C r^{3+}, C o^{3+}, I n^{3+}$ 

などの3個金属。

mは水和水のモル数であり、nはアニオンA上の電荷であり、xは 1より小さい数である。) , (OH),,CO, である。

【0059】ハイドロタルサイト状化合物は、米国特許明細書第3.539.306号に記載されているような各種の方法によって合成できる。

13

【0060】一般に合成ハイドロタルサイトは、カチオン性成分の溶液とアニオン性成分の溶液との共沈殿によって生成できる。最も容易に入手できるハイドロタルサイトは、マグネシウムーアルミニウムハイドロキシカーボネートハイドレートであろう。好ましいハイドロタルサイトは、製造業者によってMg4、Al、(OH)1、10CO、・3.5H、Oと特性表示されている商用名DHT-40として入手できるマグネシウムアルミニウムヒドロキシハイドレートである。

【0061】上記無機金属塩は一種または二種以上使用することもできる。

【0062】本発明における(F)無機金属塩の添加量は、(A)ポリアミドエラストマー、(B)ポリフェニレンエーテル、(C)ポリアミド樹脂、(D)変性ビニル系重合体および(E)スチレン系樹脂の合計量

((A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 100重20量部) に対し、0~10重量部、好ましくは0.01~5重量部の範囲である。

【0063】(F)無機金属塩の添加量が10重量部を越える場合は耐衝撃性が悪くなるので好ましくない。

【0064】本発明の樹脂組成物の製造法に関しては特に制限されないが、例えば(A)ポリアミドエラストマー、(B)ポリフェニレンエーテル、(C)ポリアミド樹脂、(D)変性ビニル系樹脂、(E)スチレン系樹脂および必要に応じ(F)無機金属塩の混合物をバンバリーミキサー、ロール、単軸または2軸のエクストルーダ 30ーなどで溶融混練することによって製品化される。

【0065】本発明の樹脂組成物は本発明の組成物と相溶性のある他の熱可塑性樹脂、例えば、ボリカーボネート、ポリグルタルイミド、ポリシクロヘキサンジメチレンテレフタレートなどを混合して耐衝撃性、耐熱性の改良を、ポリオレフィン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートなどを混合して耐薬品性の改良を、塩化ビニル樹脂、ハロゲン含有ポリスチレンなどを混合して難燃性の改良をすることもできる。また、スルホン酸の金属塩および該化合物含有ポリスチレン、アニオン系、カチオン系、非イオン系の界面活性剤などの帯電防止剤を添加して帯電防止性を一層向上させることも可能であり、更に必要に応じて酸化防止剤、紫外線吸収剤などの各種安定剤、顔料、染料、滑剤および可塑剤、難燃剤などを添加することもできる。

#### [0066]

【実施例】本発明をさらに具体的に説明するために、以下、実施例および比較例を挙げて説明する。なお、最終的に得られた樹脂組成物は射出成形法によって成形されたのち、下記の試験法により諸物性を測定した。

[0067]

アイソット衝撃強さ: ASTM D256-56A

曲げ弾性率:ASTM D790

熱変形温度: ASTM D648 (18.56 kg/cm² 荷重)

表面固有抵抗値: 2 mm × 40 mm 円板を用い、室温23°C、湿度50%RH雰囲気下で測定した。測定には東亜電波工業(株)製の超絶縁抵抗計SM-10E型を用いた。

○ 層状剥離防止性:射出成形直後の成形品を折り曲げして、表面の観察により行い、②:極めて良好、〇:良好、×:成形品が層状剥離を起こすを判定基準とした。【0068】また、実施例中の部数および%は、それぞれ重量部および重量%を示す。

## 【0069】参考例

(1) (A) ポリアミドエラストマーの調製

A-1:カブロラクタム40.0部、数平均分子量が1500のポリエチレングリコール55.2部およびテレフタル酸6.4部を"イルガノックス"1098(酸化防止剤)0.2部および三酸化アンチモン触媒0.1部と共にヘリカルリボン撹拌翼を備えた反応容器に仕込み、窒素置換して260℃で60分間加熱撹拌して透明な均質溶液とした後、260℃、0.5mmHq以下の条件で3時間重合し、粘ちょうで透明なポリマを得た。

【0070】ポリマを冷却ベルト上にガット状に吐出し、ベレタイズすることによって、ベレット状のポリエーテルエステルアミド(A-1)を調製した。

【0071】A-2:数平均分子量が4000のポリエチレングリコールにアクリロニトリルを反応させ、さらに水素添加反応を行なうことにより、両末端がアミノ基であるポリエチレングリコールジアミンを得た。これとテレフタル酸とを常法により塩反応を行ない、ポリエチレングリコールジアンモニウムテレフタレートの40%溶液を得た。

【0072】 濃縮罐に上記40%のポリエチレングリコールジアンモニウムテレフタレート水溶液を120部、40%へキサメチレンジアンモニウムアジベート水溶液16部を投入し、常圧で内温が110℃になるまで約2時間加熱し、80% 濃度に濃縮した。続いて重合罐に上20記濃縮溶液を移行し、重合罐内に窒素を流しながら加熱を開始した。

【0073】内温が120℃になった時点で、所定量のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムと、1、3、5 ートリメチル-2、4、6-トリ(3、5-ジーt-ブチルヒドロキシベンジル)ベンゼンを10部添加し、攪拌を開始して内温が245℃になるまで昇温した。245℃で18時間加熱し重合を完結させた。

【0074】以降はA-1と同様にしてペレット状のポリエーテルアミド(A-2)を調製した。

50 【0075】(2)(B)ポリフェニレンエーテルの調

鄣

製)を使用した。

B-1: CPX-100L (三菱ガス化学社製) を用いた。

B-2:ポリフェニレンエーテル100部に対し、無水マレイン酸3部を混合し、ベント付30mmφ2軸押出機で、樹脂温度300℃で溶融混練、押出を行なうことによってペレット状の変性ポリフェニレンエーテル(B-2)を調製した。得られたペレット10gを粉砕機で微粉末にした後、100mlのメタノールを用いてソックスレー抽出を行った。抽出した試料をNMR分析したとこの3、無水マレイン酸の含有量は2.3%であった。【0076】(3)(C)ポリアミド樹脂の調製C-1:CM-1021(ナイロン-6、東レ(株)

製) を使用した。 C-2: CM-3001 (ナイロン-66、東レ (株)

【0077】(4)(D)変性ビニル系重合体の調製 D-1:スチレン96%、メタクリル酸4%の混合物を 懸濁重合して、変性ビニル系重合体(D-1)を調製した。

D-2: スチレン80%、アクリロニトリル15%、メタクリル酸5%の混合物を懸濁重合して変性ビニル系重合体 (D-2) を調製した。

D-3:スチレン95%、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル5%を懸濁重合して変性ビニル系重合体(D-3)を調製した。

D-4:スチレン99.5%、グリシジルメタクリレート0.5%を懸濁重合して変性ビニル系重合体 (D-4)を調製した。

D-5: スチレン95%、2-ビニル-2-オキサゾリ 30ン5%を溶液重合した後、溶媒を除去して変性ビニル系 重合体(D-5)を調製した。

D-8: "ダイラーク" 232 (ARCO社製) を用いた。

【0078】(5)(E)スチレン系樹脂の調製 E-1:ジエンNF35A(旭化成(株)製)10部を スチレン90部およびt-ブチルパーオキシベンゾエート0.05部に溶解後、塊状重合してグラフト重合体 (E-1)を調製した。

E-2:ポリブタジエンラテックス(ゴム粒子径0.3 1μm、ゲル含率88%)50部(固形分換算)の存在下でスチレン76%、アクリロニトリル24%からなる単量体混合物50部を乳化グラフト重合した。得られたグラフト共重合体は硫酸で凝固し、苛性ソーダで中和、洗浄、ろ過、乾燥してバウダー状のグラフト共重合体(E-2)を調製した。

16

E-3:スチレン76部、アクリロニトリル24部を懸 濁重合して共重合体(E-3)を調製した。

【0079】(6)(F)無機金属塩の調製

F-1:ケイ酸マグネシウム (ハイトロンA、竹原化学 (株) 製) を使用した。

F-2: チオシアン酸カリウム (片山化学 (株) 製) を使用した。

【0080】実施例1~18

参考例で調製した(A)ポリアミドエラストマー、

(B)ポリフェニレンエーテル、(C)ポリアミド樹脂、(D)変性ビニル系重合体、(E)スチレン系樹脂20 および(F)無機金属塩を表1に示した配合比で混合し、ベント付40mmφ押出機で、280℃で溶融混練、押出しを行うことによって、ベレットを製造した。次いで射出成形機により、シリンダー温度280℃、金型温度80℃で試験片を成形し、各物性を測定した。表面固有抵抗値は射出成形した厚さ2mmの円板を用いた。

【0081】(1)成形直後、洗剤"ママレモン"(ライオン(株)製)水溶液で洗浄し、続いて蒸留水で十分洗浄してから表面の水分を取り除いた後、50%RH、23℃で24時間調湿して測定した。

【0082】(2)成形後、50%RH、23℃中に100日間放置した後、洗剤"ママレモン"水溶液で洗浄し、続いて蒸留水で十分洗浄してから表面の水分を取り除いた後、50%RH、23℃で24時間調湿して測定した。

【0083】測定結果を表2に示した。

[0084]

【表1】

17

# 【表1】

					一	肾	推		成	物			
		ポリアミド				ポリア			ニル	スチレン系		無機金属塩	
	エラストマ		レンエーテ		樹脂		<b>系重合体</b>		樹脂			- }	
	- (A)		()	ル(B)		(C)		(D)		(E)		(F)	
		名称	部数	名称	部数	名称	部数	名称	部数	名称	部数	名称	部数
	1	A-1	10	B-1	40	C-1	15	D-1	5	E-1	30	-	-
	2	A-1	10	B-1	40	C-1	15	D-2	5	E-1	30	-	-
	3	A-1	10	B-1	40	C-1	15	D-3	5	E-1	30	-	-
	4	A-1	10	B-1	40	C-1	15	D-4	5	E-1	30	-	-
実	5	A-1	10	B-1	40	C-1	15	0-5	5	E-1	30	-	-
	6	. A-1	10	B-1	40	C-1	15	D-6	5	E-1	30	-	-
	7	A-2	10	B-1	40	C-1	15	D-1	5	E-1	30	-	-
	8	A-2	10	B-1	40	C-1	15	D-3	-5	E-1	30	-	- 1
施	9	A-1	10	B-1	40	C-2	15	D-3	5	E-1	30	-	-
<i>"</i>	10	A-1	10	B-1	20	C-1	15	D-1	5	E-1	50	- 1	-
	11	A-1	10	B-1	60	C-1	15	D-1	5	E-2	10	-	-
	12	A-1	10	B-1	40	C-1	5	D-2	5	E-2E-3	20/20	1 - 1	-
	13	A-1	10	B-1	75	C-1	10	<b>D</b> -1	5	-	-	-	-
例	14	A-1	10	B-18-2	20/20	C-1	15	D-1	5	E-1	30	-	-
	15	A-1	10	B-1	40	C-1	15	D-3	15	E-1	20	-	
	16	A-1	10	B-1	40	C-1	15	D-1	5.	E-1	30	F-1	1.0
	17	A-1	10	B-1	40	C-1	15	D-3	5	E-1	30	F-2	0.3
L	18	A-1	10	B-1	40	C-1	40	D-1	10	<u> </u>	-	-	<u>  -</u> _
	1	A-1	0.5	B-1	40	C-1	15	D-1	5	E-1	39.5	-	[ -
	2	A-1	50	B-1	30	C-1	15	D-1	5	-	-	-	-
比	ı	A-1	1	B-1	97	C-1	1	D-1	1	-	_	-	-
1	4	A-1	10	-	-	C-1	15	D-1	5	E-1	70	-	-
較	5	A-1	10	B-1	40	-	_	D-1	5	E-1	45	-	-
1	6	A-1	10	B-1	15	C-1	70	0-1	5		-	-	-
	7	A-1	10	B-1	40	C-1	15		-	E-1	35	-	-
例	1	l l	10	B-1	15	C-1	15	D-1	60		25	-	-
1	9	i	10	B-1/B-2	1.	1	15	-	] -	E-1	35		-
L	10	A-1	1	B-1	1	C-1	0.5	D-1	0.5	E-1	97		<u></u> _

【表2】

## 【表2】

19

			物	<del></del>	層状剥離		
1		1/2"アイゾッ 画行弾性率		熱変形温度	打抵抗值		
		ト衝撃強さ		18.56kg/cm <sup>2</sup> 荷建	成形直後	1001放置接	·
L		(kgcm/cm·/+)	(kg/cm <sup>2</sup> )	(%)	(Ω)	(Ω)	防止性
	1	15	23200	126	9×10	8×10 <sup>10</sup>	0
	2	13	23300	126	8×10 <sup>10</sup>	8×10 <sup>10</sup>	<b>Ø</b>
	3	11	23300	125	7×10 <sup>10</sup>	7×10 <sup>10</sup>	
1	4	10	23300	126	7×10 <sup>10</sup>	6×10 <sup>10</sup>	0
奥	5	11	23400	125	7×10 <sup>10</sup>	7×10 <sup>10</sup>	0
١.	6	11	23300	127	8×10 <sup>10</sup>	7×10 <sup>10</sup>	0
1	7	13	23400	126	7×10 <sup>11</sup>	5×10 <sup>11</sup>	0
1	8	9	23500	126	6×10 <sup>11</sup>	4×10 <sup>11</sup>	0
施	9	9	23400	126	4×10 <sup>11</sup>	3×10 <sup>11</sup>	0
1	10	12	22900	105	2×1011	1×10 <sup>11</sup>	0
	11	17	23100	131	8×10 <sup>10</sup>	7×1010	.0
]	12	21	22900	123	8×10 <sup>10</sup>	7×1010	0
İ	13	10	23700	137	1×10 <sup>11</sup>	9×10 <sup>10</sup>	0
例	14	- 16	23100	122	1×10 <sup>11</sup>	1×10 <sup>11</sup>	•
	15	11	23200	124	9×10 <sup>10</sup>	8×1010	0
	16	14	23500	127	1×10 <sup>11</sup>	9×10 <sup>10</sup>	•
	17	10	23300	124	4×10 <sup>10</sup>	3×10 <sup>10</sup>	0
L	18	9	23800	129	1×10 <sup>11</sup>	8×10 <sup>10</sup>	0
	1	11	24100	133	5×10 15	5×1013	0
	2	31	16100	86	7×10 <sup>8</sup>	5×10 <sup>8</sup>	×
此	3	2	26200	171	>1016	>1016	0
	4	7	22100	88	5×10 <sup>11</sup>	3×10 <sup>11</sup>	0
較	5	17	23700	129	3×10 <sup>14</sup>	1×10 <sup>14</sup>	Ø
	6	3	22400	81	4×10 <sup>11</sup>	2×1011	Ø
	7	6	23600	128	6×10 <sup>10</sup>	5×10	×
例	8	7	23800	95	5×10 <sup>13</sup>	4×10 <sup>13</sup>	0
	9	8	23400	127	6×10 <sup>19</sup>	5×1010	×
Ĺ	10	7	22100	89	>10 <sup>16</sup>	>10 <sup>18</sup>	0

【0086】比較例1~10

参考例で調製した(A)ポリアミドエラストマー、

(B) ポリフェニレンエーテル、(C) ポリアミド樹 脂、(D)変性ビニル系重合体、(E)スチレン系樹脂 を表1に示した配合比で混合し、実施例と同様の方法で 各物性を測定した。測定結果を表2に示す。

【0087】表2の結果から、次のことが明らかであ る。本発明の樹脂組成物(実施例1~18)はいずれも 衝撃強さ、曲げ弾性率に代表される機械的性質と耐熱性 が均衡してすぐれ、かつ低い表面固有抵抗値を有してい る。しかも表面洗浄や経時変化によっても抵抗値はほと んど変化せず、すぐれた永久帯電防止性を発揮する。す なわち、本発明の樹脂組成物はすぐれた機械的性質、耐 50 量部を越える場合(比較例6)は耐熱性が悪く好ましく

熱性および永久帯電防止性を兼備し、かつ層状剥離防止 性にすぐれる。

40 【0088】一方、ポリアミドエラストマー(A)の配 合量が1重量部未満の場合(比1)は抵抗値が高く、帯 電防止性が劣り、40重量部を越える場合(比較例2) は曲げ弾性率、耐熱性が劣るので好ましくない。

【0089】ポリフェニレンエーテル(B)の配合量が 95 重量部を越える場合(比較例3)は帯電防止性が劣 り、5重量部未満(比較例4)では耐熱性が悪く好まし くない。

【0090】ポリアミド樹脂(C)の配合量が1重量部 未満(比較例5)では帯電防止性が改善されず、60重 ない。

【0091】変性ビニル系重合体(D)の配合量が0. 1重量部未満(比較例7、9)では耐衝撃性が劣り、か つ成形品が層状剥離し、使用できなく、50重量部を越 える場合(比較例8)は耐熱性、帯電防止性が悪く好ま しくない。

【0092】また、スチレン系樹脂(E)が95重量部 を越える場合(比較例10)は耐熱性、帯電防止性が悪\* \*く好ましくない。

[0093]

【発明の効果】本発明の熱可塑性樹脂組成物はすぐれた 永久帯電防止性、耐衝撃性、剛性などの機械的性質、耐 熱性を示し、かつ層状剥離防止性にすぐれる。

22

【0094】本発明により、機械的性質にすぐれた永久 帯電防止性樹脂を提供することができた。

# フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>3</sup> C 0 8 L 77/00	識別記号 LQS LQV	庁内整理番号 9286-4J 9286-4J	FI	技術表示箇所
101/02	LSY	7242 – 4 J		